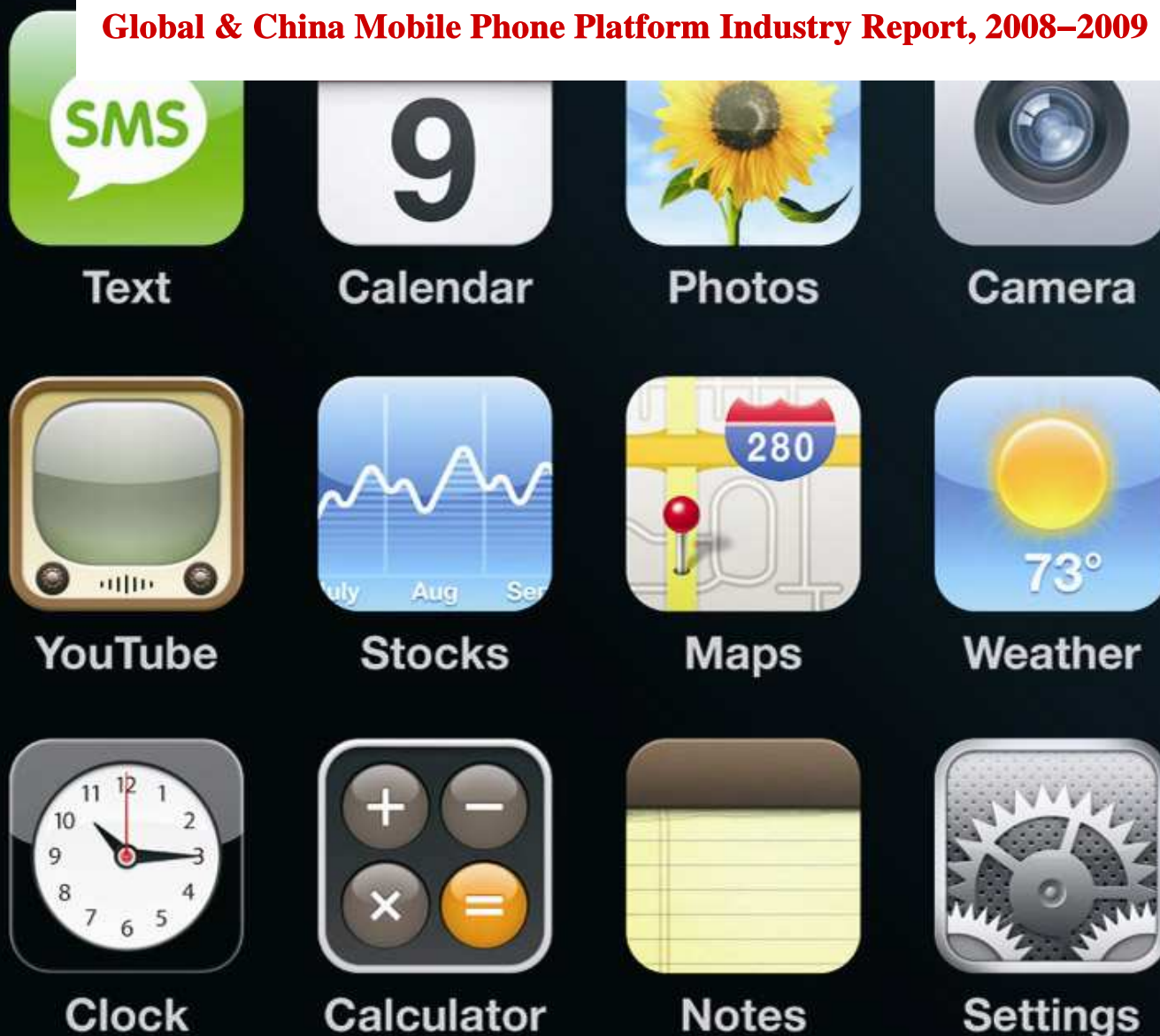


## 2008-2009 年全球及中国手机平台 行业研究报告

Global & China Mobile Phone Platform Industry Report, 2008-2009



版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

序号	CA062	报告名称	2008-2009 年全球及中国手机平台行业研究报告				
字数	3.3 万	图表数量	130	报告页数	180	完成时间	09 年 2 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	8000	纸质版价格(RMB)			7000
摘要	<p>手机平台的核心是基频，基频也是整个手机中最关键的元件。</p> <p>2009 年手机行业最火热的非智能手机莫属。随着硬件性能的增强，手机越来越像一台 PC。而高速 3G 时代的到来和硬件性能的配合，手机正在进入移动互联网时代。这就意味着越来越多的手机将拥有开放式的操作系统和全网页浏览能力，也就意味着智能手机的份额将大大提升。而苹果 iPhone 的成功也刺激了 PC 厂家纷纷进入智能手机领域。</p> <p>在 2 月 16 日的全球通讯行业大会上，电脑大厂宏基推出了 8 款智能手机，并表示 3 年内要占其总收入的 10%，那将是近 20 亿美元的不小数目。戴尔也将于 2 月底推出戴尔品牌的智能手机，东芝和惠普则表示会加大智能手机领域内的投入。</p> <p>手机平台厂家自然也加大了对智能手机平台的开发力度。黑手机先锋联发科当仁不让，2009 年 2 月中旬，宣布其第一款 GSM/GPRS 智能手机芯片 MT6253，已被运用在 GSM/GPRS 网络的手机上。联发科首款 GSM/GPRS 手机单芯片方案 MT6253 集成了数字基频 (DBB)、模拟基频 (ABB)、电源管理 (PM)、射频收发器 (RF Transceiver) 等手机芯片基础元器件，并且支持手机相机、高速 USB 以及 D 类音频功率放大器等丰富的多媒体功能。短时间内推出这样高集成化的 IC，只有依靠 SiP 封装。如果走 ASIC 的老路，开发时间最少增加 3 倍。</p> <p>同时推出的还有智能手机解决方案 MT6516，MT6516 支持 WVGA 级别的 LCD 解析度、MPEG-2 解码、并且整合了多种视频编解码器 (Video Codec) 以支持 CMMB、DVB-T、DVB-H 等手机电视应用标准。毫无疑问，联发科会支持 Windows Mobile。</p> <p>高通的 MSM72XX 系列是众多智能手机厂家所采用的，不过这系列的芯片并非为智能手机所设计。为了加大智能手机市场的拓展力度，高通特别推出了针对智能手机的 SNAPDRAGON 平台，性能强大无比。目前已经确认有东芝和 HTC 的 1 款手机采用该平台，该平台也可以用于网络笔记本电脑，</p>						

支持最大 12 英寸屏幕。CPU 运算速率达到 1GHz，DSP 运算速率达到 600MHz，支持 WLAN，GPS，支持 37 英寸大屏幕级别的 720P 显示精度。支持手机电视，包括日本的 ISDB-T 和欧洲的 DVB-H。支持 1200 万像素照相。

新加入战局的还有 Marvell。Marvell 在 2006 年以 6 亿美元收购 INTEL 的手机通讯部门，源自 XScale 技术的 Marvell 的 PXA 系列处理器在高端智能手机领域可谓呼风唤雨。在 2008 年，Marvell 分为两条路线。一条是 PXA930，将应用处理器和 3G 的 Modem 合而为一；另一条是应用处理器，包括 PXA310、PXA312、PXA320、PXA168。PXA930 是 Marvell 重点推介，支持 3G 的 Modem，集成电源管理，CPU 速率也达到 1GHz。

不过智能手机也有两派，一派主张将应用处理器和基频处理器分开，另一派主张集成在一起。苹果、诺基亚和日本厂家支持前者，索爱、宏达电、黑莓、MOTO、三星和 LG 支持后者。这也是为什么英飞凌、德州仪器、意法半导体、NXP 不推出单片智能手机基频的原因之一。因为它们也是苹果、诺基亚和日本厂家的支持者。

2008 年，手机平台行业发生了两件大事。一件是意法半导体、NXP 与爱立信移动平台合并三者的手机业务，另一件是德州仪器退出通用型基频市场。

2008 年 4 月，意法半导体与 NXP 无线部门合并组成新公司，新公司在 2008 年 8 月初运营。2008 年 8 月下旬，新公司再合并爱立信旗下的爱立信移动平台公司（EMP），最终合并到 2009 年 2 季度完成。EMP 在 2007 财年收入大约为 5 亿美元。NXP 擅长 DSP 运算与射频，意法半导体擅长射频与模拟，爱立信移动平台擅长通讯 Modem。三强合作，足以与德州仪器、高通抗衡。

在 2008 年 10 月 20 日，德州仪器对其手机基频战略做了重大调整。德州仪器计划出售其通用型手机基频部门，而为诺基亚等厂家定制基频的部门则继续保留。出售其通用型手机基频部门，可以让德州仪器每年减少 2 亿美元左右的花费。通用型手机基频部门的产品主要是 LoCosto 和 eCosto，其在 2008 年带来的收入只占德州仪器无线事业部收入的 10%，而定制基频部门的收入则占德州仪器无线部门收入的 65%。预计通用型手机基频部门将在 2009 年 2 季度找到买家，如果找不到，德州仪器会关闭该部门。德州仪器在定制型基频领域决不会退出，相反会加大投入和意法半导体竞争，因为定

	制型基频是德州仪器的核心产品。
正文 目录	<p>第一章 全球手机市场</p> <p>第二章 中国手机市场与产业</p> <p>2.1、中国手机市场</p> <p>2.2、中国手机出口现状</p> <p>2.3、中国智能手机市场</p> <p>第三章 手机及手机基频发展趋势</p> <p>3.1、移动互联网时代即将到来</p> <p>3.2、HSPA 大规模应用已经展开</p> <p>3.3、手机基频发展趋势</p> <p>    3.3.1、手机基频简介</p> <p>    3.3.2、智能手机基频开发商增多</p> <p>    3.3.3、封装仍然是关键</p> <p>3.4、基频行业现状</p> <p>第四章 手机硬件结构分析实例</p> <p>4.1、智能手机硬件结构实例</p> <p>    4.1.1、黑莓 BOLD</p> <p>    4.1.2、黑莓 STORM</p> <p>    4.1.3、HTC Touch Pro</p> <p>    4.1.4、索爱 XPERIA X1</p> <p>    4.1.5、T-MOBILE T1</p> <p>    4.1.6、MOTO KRAVE ZN4</p> <p>    4.1.7、NOKIA N95</p> <p>    4.1.8、IPHONE 3G 16GB</p> <p>4.2、智能手机 CPU 发展趋势</p> <p>第五章 全球手机平台市场</p> <p>5.1、全球手机平台市场占有率</p> <p>5.2、智能手机 CPU 现状</p> <p>第六章 手机厂家研究</p> <p>6.1、诺基亚</p> <p>6.2、摩托罗拉</p> <p>6.3、三星</p>

	<p>6.4、索尼爱立信 6.5、LG 6.6、国产手机厂家平台研究     6.6.1、天宇朗通     6.6.2、联想     6.6.3、金立</p> <p>第七章 手机平台厂家研究</p> <p>7.1 高通 7.2、德州仪器 7.3、飞思卡尔 7.4、英飞凌 7.5、BROADCOM (博通) 7.6、联发科 7.8、展讯 7.8、天碁科技 (T3G) 7.9、意法半导体     7.9.1、爱立信移动平台 (EMP)     7.9.2、NXP</p>
<p>部 分 图 表 目 录</p>	<p>2007-2012 年全球手机出货量与智能手机所占比例统计及预测 2007-2008 年每季度全球手机出货量与增速统计 2007-2008 年每季度手机出货量地域分布 2007-2008 年每季度全球手机出货技术分布 2008 年全球主要手机品牌市场占有率 2008 年全球主要智能手机厂家市场占有率 2004-2012 年中国手机市场销量与智能手机所占比例统计 2008 年中国主要手机厂家市场占有率 2004-2012 年中国手机产量统计及预测 1999-2008 年中国手机出口量统计 2002-2008 年中国手机出口金额统计 2008 年中国手机出口地域分布 2008 年中国智能手机主要厂家市场占有率 手机发展趋势图 1995-2012 年手机发展趋势预测 2008-2013 年手机通讯协议栈发展趋势 拉美 UMTS-HSPA 网络分布图 手机基本结构 英飞凌 PMB8878 电子显微镜透视 N95 内部框架图 2007、2008 年全球手机平台主要厂家市场占有率 (按出货量)</p>

2008 年中国手机平台主要厂家市场占有率（按出货量）  
 诺基亚 2005 年 3 季度到 2008 年 4 季度每季度手机中国地区出货量统计  
 三星 2005 年 1 季度到 2008 年 4 季度每季度手机出货量统计  
 2005 年 1 季度到 2008 年 4 季度索尼爱立信出货量与平均销售价格统计  
 2005 年 4 季度到 2008 年 4 季度 LG 手机每季度出货量（按制式）  
 天宇朗通组织结构图  
 金立通信公司结构  
 金铭电子组织结构  
 2004-2008 年每季度高通 MSM 芯片出货量统计  
 德州仪器手机基频分布  
 TCS2315 内部框架图  
 OMAPV1035 内部框架图  
 OMAPV 系列软件结构  
 2006-2008 年飞思卡尔产品收入结构  
 2006 财年 4 季度到 2008 财年 4 季度英飞凌通讯部门收入统计  
 英飞凌手机领域路线图  
 PMB7870 内部框架图  
 X-GOLD-608 内部与应用框架图  
 XMM2050 软件结构图  
 XMM2051 内部框架图  
 2006 年 1 季度到 2008 年 4 季度博通产品收入结构  
 BCM2124 内部框架图  
 BCM21331 内部框架图  
 BCM2133 内部框架图  
 BCM2152 内部框架图  
 BCM21551 内部框架图  
 BCM2153 内部框架图  
 2001-2009 年联发科收入与毛利率统计及预测  
 联发科 2006-2009 路线图  
 联发科蓝牙产品路线图  
 MT6229 内部框架图  
 联发科 TD-SCDMA 系统解决方案框架图  
 联发科 TD-SCDMA 手机解决方案核心芯片 AD6905 内部框架图  
 AD6900 EDGE 平台框架图  
 AD6722 内部框架图  
 AD6721 内部框架图  
 AD6720 内部框架图  
 WCDMA 平台框架图  
 TD-SCDMA 平台框架图  
 AD6525 内部功能模块图  
 AD6537 内部模块图  
 AD6720 应用结构图  
 展讯 2006 年 1 季度到 2008 年 1 季度产品 ASP 统计  
 展讯 2006 年 1 季度到 2008 年 1 季度成本结构

图 4-59 展讯 2003-2008 年收入统计与预测  
展讯 2006 年 1 季度到 2008 年 4 季度收入与毛利率统计  
展讯 EDGE 基频产品规划图  
展讯 3G 基频路线图  
展讯的 SC6600V CMMB 手机电视解决方案  
展讯手机电视多媒体解决方案发展路线图  
SC8800H 典型应用图  
SC8800D 典型应用图  
T3G 研发人员分配比例  
T3GTD-SCDMA 基频处理器内部框架图  
T3GTD-SCDMA 基频处理器应用框架图  
T3GTD-SCDMA 基频处理器协议栈图  
T3GTD-SCDMA 手机参考设计图  
T3G 的产品路线图  
意法半导体 2008 年收入结构  
意法半导体连续 2005-2008 年收入统计  
意法半导体 2008 年地区收入结构比例  
意法半导体组织结构  
意法半导体连续 2003-2008 年 无线领域的收入  
EMP 产品路线图  
NXP 2.5G 中国路线图  
NXP 2007 年 52XX 系列产品分布  
NXP 2007 年 49XX 系列产品分布  
NXP 与联发科 2G 路线图  
PNX4902 框架图  
PNX54901/03 内部框架  
PNX5209 框架图  
PCF5213 内部框架图  
Nexperia System Solution 5210 系统图  
NXP TD-SCDMA7130 平台框架图  
NXP7210 平台框架图  
PNX5221 内部框架图

2008 年全球前十三大品牌厂家出货量统计  
2008 年中国手机产量前 25 大厂家产量排行  
2008 年中国手机出口前 23 个国家及地区  
黑莓 BOLD 技术参数  
黑莓 BOLD 零件构成  
黑莓 STORM 技术参数  
黑莓 STORM 零件构成  
HTC Touch Pro 技术参数  
HTC Touch Pro Bill of Materials 原料清单 (CDMA)  
索爱 XPERIA X1 技术参数  
索爱 XPERIA X1 零组件配置



T-MOBILE T1 技术参数  
T-MOBILE T1 原料清单  
MOTO KRAVE ZN4 技术参数  
MOTO KRAVE ZN4 零组件配置清单  
N95 零组件配置清单  
IPHONE 3G 16GB 技术参数  
APPLE IPHONE 16GB 零件供应清单  
全球主要手机平台厂家 2008 年收入统计  
2008 年到 2009 年 3 月 110 款上市智能手机 CPU 与操作系统一览  
诺基亚 30 款典型手机零组件配置清单  
摩托罗拉 3 款手机零组件配置清单  
三星 20 款典型手机零组件配置清单  
索爱手机平台一览  
LG 17 款典型手机零组件配置清单  
天语 11 款典型手机配置清单  
联想 10 款典型手机配置清单  
金立 5 款典型手机配置清单  
高通 7 家分公司简介  
2002-2007 年高通芯片出货量及市场占有率统计  
德州仪器手机平台  
2006 年 1 季度到 2008 年 4 季度飞思卡尔手机部门收入统计  
英飞凌先进平台简介  
英飞凌基频产品  
博通历次收购简介  
博通手机产品  
ADI 手机平台产品  
ADI 手机基频产品  
展讯 2005-2008 年手机基频芯片出货量统计  
NXP 基频产品

## 如何申请购买报告

- 1, 请填写《研究报告订购协议》([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。
- 2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。
- 3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:  
开户行: 交通银行世纪城支行 帐号: 110060668012015061217  
户名: 北京水清木华科技有限公司
- 4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570



Title	<b>Global &amp; China Mobile Phone Platform Industry Report, 2008-2009</b>	Pages	180
Price	PDF US \$ 2,500      Hard Copy US \$ 2,300 Enterprisewide US \$ 3,800	Release Date	Feb/2009
Abstract	<p>Base band, the core of mobile phone platform, is also the key component of a mobile phone.</p> <p>The year of 2009 will witness the prosperity of smart phone. With the increasingly enhancement of hardware performance, a mobile phone will be more like a PC. In addition, as 3G is arriving, the mobile phone is marching into the mobile internet era, which indicates that more and more mobile phones will have open operating system and the function of full web browsing. Meanwhile, the success of iPhone has promoted more PC manufacturers focus on smart phones.</p> <p>During the world's communication industry conference on Feb 16 2009, Acer announced eight new smart phone models, and the revenue from those eight models are expect to account for 10% of Acer's total revenue in the next three years, which is about US \$2billion. Moreover, Dell will also launch its own smart phone by the end of Feb 2009, Toshiba and HP will also tend to enlarge their smart phone investments.</p> <p>Mobile phone platform manufacturers certainly have made more efforts on smart phone platform developments. In the middle of Feb, 2009, MediaTek announced its launch of MT6253, its first GSM/GPRS smart phone chip, which integrates the basic components like DBB, ABB, PM, and RF Transceiver, it also supports abundant multimedia functions such as camera, high speed USB and Class D audio power amplifier. Not like ASIC, the SiP packaging has made the success of such a high-integrated IC in a short term.</p> <p>MT6516, another smart phone solution simultaneously launched by MediaTek, which supports WVGA LCD resolution, MPEG-2 decoding, and mobile phone TV application standards like CMMB, DVB-T, and DVB-H, by the integration of various video codec. And no doubt that MediaTek supports Windows Mobile.</p> <p>Although it has been adopted by many smart phone manufacturers, Qualcomm's MSM72XX series was not</p>		

originally designed for smart phone. In order to expand the smart phone market, Qualcomm launched the dramatically SNAPDRAGON platform focus on smart phones. So far, it has been adopted by Toshiba and HTC. Moreover, its CPU and DSP speed can respectively reach 1GHz and 600MHz, moreover, it supports WLAN, GPS, 12 million-pixel camera and mobile phone TV (including ISDB-T and DVB-H)

Marvell, the new entrant, it had acquired INTEL's mobile phone communication division at the cost of US \$600 million in 2006. Originated from XScale technology, Marvell's PXA processor series achieved a great performance in the high-end smart phone sector. Marvell had divided into two routes in 2008, one was PXA930, integrating application processor and 3G Modem; the other was application processor, including PXA310, PXA312, PXA320 and PXA168.

However, there are two sides regarding smart phones, one side insists to separate application processor and base band processor, while the other side claims to the integration. Apple, Nokia and Japanese manufacturers are supporting the former, while Sony Ericsson, Acer, HTC, BlackBerry, MOTO, Samsung and LC are for the other side. It also the main reason why Infineon, TI, ST, and NXP do not launch single-chip smart phone base band, because they are also the supporters of Apple, Nokia and Japanese Manufacturers.

Two big events had taken place in global mobile phone platform industry in 2008, one was mobile phone business integration of ST, NXP and Ericsson mobile phone platform (EMP), and the other was TI quits the general base band market.

In Apr, 2008, ST and NXP wireless division co-established a new company, which started its operation in the beginning of Aug, 2008. Then the new company starts to remerge the EMP (the revenue of EMP was US \$500 million in 2007FY), and the merger is expected to complete in 2009Q2. NXP, ST and EMP are respectively good at DSP operation and radio frequency, radio frequency and analog, and communication Modem.

TI had made significant adjustments to its mobile phone base band strategy on Oct 20, 2008. It planned to

	<p>sell its general mobile phone base band division, which could save approximately US \$200 million expenditure each year, but it still maintained the division producing custom base band for manufacturers like Nokia. The main products of TI's general mobile phone base band division were LoCosto and eCosto, and the annual revenue of this division only accounted for 10% of TI's total wireless revenue in 2008, while the proportion for the custom base band division was 65%. It is expected the general mobile phone base band division will be sold out in 2009Q2; otherwise, TI will shut it up. However, TI will enlarge investment in custom base band sector, to compete with ST rather than quit.</p>
<p>Contents</p>	<p><b>1. Global Mobile Phone Market</b></p> <p><b>2. China Mobile Phone Market</b></p> <p>2.1 Mobile Phone Market</p> <p>2.2 Export</p> <p>2.3 Smart Phone Market</p> <p><b>3. Development Trend of Mobile Phone and Baseband</b></p> <p>3.1 Mobile Internet Era Is Forthcoming</p> <p>3.2 Mass Application of HSPA Has Started</p> <p>3.3 Development Trend of Mobile Phone Baseband</p> <p>3.3.1 Brief Introduction</p> <p>3.3.2 Number of Smart Phone Baseband Developers Increased</p> <p>3.3.3 Package Is Still the Key</p> <p>3.4 Status Quo of Baseband Industry</p> <p><b>4. Mobile Phone Hardware Structure</b></p> <p>4.1 Hardware Structure of Smart Phone</p> <p>4.1.1 BlackBerry BOLD</p> <p>4.1.2 BlackBerry STORM</p> <p>4.1.3 HTC Touch Pro</p> <p>4.1.4 Sony Ericsson XPERIA X1</p> <p>4.1.5 T-MOBILE T1</p> <p>4.1.6 MOTO KRAVE ZN4</p> <p>4.1.7 NOKIA N95</p> <p>4.1.8 IPHONE 3G 16GB</p> <p>4.2 Development Trend of Smart Phone CPU</p> <p><b>5. Global Mobile Phone Platform Market</b></p> <p>5.1 Market Share Distribution</p> <p>5.2 CPU of Smart Phone</p>

	<p><b>6. Main Mobile Phone Vendors</b></p> <p>6.1 Nokia</p> <p>6.2 Motorola</p> <p>6.3 Samsung</p> <p>6.4 Sony Ericsson</p> <p>6.5 LG</p> <p>6.6 Chinese Mobile Phone Platform Manufactures</p> <p>6.6.1 Tianyu Communication Equipment</p> <p>6.6.2 Lenovo</p> <p>6.6.3 Gionee</p> <p><b>7. Mobile Phone Platform Vendors</b></p> <p>7.1 Qualcomm</p> <p>7.2 Texas Instruments</p> <p>7.3 Freescale</p> <p>7.4 Infineon</p> <p>7.5 BROADCOM</p> <p>7.6 MTK</p> <p>7.8 Spreadtrum</p> <p>7.8 T3G</p> <p>7.9 STM</p> <p>7.9.1 EMP</p> <p>7.9.2 NXP</p>
<p>Selected Charts</p>	<p>Global Mobile Phone Shipment and the Proportion of Smart Phones, 2007-2012e</p> <p>Quarterly Global Mobile Phone Shipment and Growth, 2007-2008</p> <p>Regional Distribution of Quarterly Global Mobile Shipment, 2007-2008</p> <p>Technology Distribution of Quarterly Global Mobile Shipment, 2007-2008</p> <p>Global Market Share Distribution of Major Mobile Phone Vendors, 2008</p> <p>Global Market Share Distribution of Major Smart Phone Vendors, 2008</p> <p>China's Mobile Phone Shipment and the Proportion of Smart Phones, 2004-2012e</p> <p>Chinese Market Share Distribution of Major Mobile Phone Vendors, 2008</p> <p>China's Mobile Phone Output, 2004-2012e</p> <p>China's Mobile Phone Export, 1999-2008</p> <p>China's Mobile Phone Export Value, 2002-2008</p> <p>China's Regional Distribution of Mobile Phone Export, 2008</p> <p>Chinese Market Share Distribution of Major Smart Phone Vendors, 2008</p> <p>Mobile Phone Development Trend, 1995-2012e</p> <p>Development Trend of Mobile Phone Communication Protocol, 2008-2013e</p> <p>UMTS-HSPA Network Distribution in Latin America</p> <p>Perspectivity of Infineon PMB8878 Electron Microscope</p> <p>Internal Framework of N95</p> <p>Global Market Share Distribution of Major Mobile Phone Baseband Vendors by Shipment, 2007and 2008</p> <p>Chinese Market Share Distribution of Major Mobile Phone Platform Vendors by Shipment, 2008</p>

<p>Quarterly Shipment of Nokia in China, Q12005-Q42008</p> <p>Quarterly Shipment of Samsung, Q12005-Q42008</p> <p>Shipment and Average Sales Price of Sony Ericsson, Q12005-Q42008</p> <p>Quarterly Shipment of LG, Q12005-Q42008</p> <p>Organization Structure of Tianyu Communication Equipment</p> <p>Organization Structure of Gionee</p> <p>Organization Structure of JM Electronics</p> <p>Quarterly Shipment of Qualcomm's MSM Chips, 2004-2008</p> <p>Mobile Phone Baseband Distribution of Texas</p> <p>Internal Framework of TCS2315</p> <p>Internal Framework of OMAPV1035</p> <p>Software Structure of OMAPV</p> <p>Freescale's Sales Revenue Structure</p> <p>Revenue of Infineon's Communication Department, FY Q42006-FY Q42008</p> <p>Internal Framework of PMB7870</p> <p>Internal &amp; Application Framework of X-GOLD-608</p> <p>Software Structure of XMM2050</p> <p>Internal Framework of XMM2051</p> <p>Products Sakes Revenue Structure of Qualcomm, Q12006-Q42008</p> <p>Internal Framework of BCM2124</p> <p>Internal Framework of BCM21331</p> <p>Internal Framework of BCM2133</p> <p>Internal Framework of BCM2152</p> <p>Internal Framework of BCM21551</p> <p>Internal Framework of BCM2153</p> <p>Revenue &amp; Gross Profit Margin of MTK, 2001-2009e</p> <p>Route Chart of MTK, 2006-2009e</p> <p>Route Chart of MTK Blue Tooth Products</p> <p>System Solution of MTK TD-SCDMA</p> <p>Platform Framework of AD6900 EDGE</p> <p>Internal Framework of AD6722</p> <p>Internal Framework of AD6721</p> <p>Internal Framework of AD6720</p> <p>Platform Framework of WCDMA</p> <p>Platform Framework of TD-SCDMA</p> <p>Internal Function Module of AD6525</p> <p>Internal Module of AD6537</p> <p>Application Structure of AD6720</p> <p>Revenue of Spreadtrum, 2003-2008</p> <p>Revenue &amp; Gross Profit Margin of Spreadtrum, Q1 2006-Q4 2008</p> <p>Spreadtrum's EDGE Baseband Products Layout</p> <p>Spreadtrum's 3G Baseband Route</p> <p>Mobile TV Solutions of Spreadtrum's C6600V CMMB</p> <p>Development Route of Spreadtrum's Mobile TV Multimedia Solutions</p>
--

Typical Application Chart of SC8800H  
 Typical Application Chart of SC8800D  
 Distributing Proportion of T3G Researchers  
 Internal Framework of T3GTD-SCDMA Baseband Processor  
 Application Framework of T3GTD-SCDMA Baseband Processor  
 Protocol Stack of T3GTD-SCDMA Baseband Processor  
 Reference Design Chart of T3GTD-SCDMA  
 Product Route Map of T3G  
 STM's Revenue Structure, 2008  
 STM's Revenue, 2005-2008  
 STM's Regional Revenue Structure, 2008  
 STM's Organization Structure  
 STM's Revenue from Wireless Business, 2003-2008  
 Product Route Chart of EMP  
 NXP 52XX Series Products Distribution, 2007  
 NXP 49XX Series Products Distribution, 2007  
 2G Route Chart of NXP and MTK  
 Framework of PNX4902  
 Internal Framework of PNX54901/03  
 Framework of PNX5209  
 Internal Framework of PCF5213  
 Nexperia System Solution 5210  
 Platform Framework of NXP TD-SCDMA7130  
 Platform Framework of NXP7210  
 Internal Framework of PNX5221  
 Shipment of Global Top 13 Mobile Phone Vendors, 2008  
 Global Top 25 Mobile Phone Vendors by Output, 2008  
 Technical Parameters of BlackBerry BOLD  
 Component Structure of BlackBerry BOLD  
 Technical Parameters of BlackBerry STORM  
 Component Structure of BlackBerry STORM  
 Technical Parameters of HTC Touch Pro  
 HTC Touch Pro Bill of Materials Sheet (CDMA)  
 Technical Parameters of Sony Ericsson XPERIA X1  
 Technical Parameters of T-MOBILE T1  
 Raw Materials Sheet of T-MOBILE T1  
 Technical Parameters of MOTO KRAVE ZN4  
 Technical Parameters of IPHONE 3G 16GB  
 Component Supply Sheet of APPLE IPHONE 16GB  
 General View of Sony Ericsson Mobile Phone Platform  
 Configuration Sheet of 17 Typical Types of LG Mobile Phone  
 Configuration Sheet of 11 Typical Types of Tianyu Mobile Phone  
 Configuration Sheet of 10 Typical Types of Lenovo Mobile Phone  
 Configuration Sheet of 5 Typical Types of Gionee Mobile Phone

Profile of Qualcomm's Seven Branch Companies Qualcomm's Chip Shipment and market Share, 2002-2007 Mobile Phone Platform of Texas Instruments Revenue of Freescale 's Mobile Phone Department, Q1 2006-Q4 2008 Profile of Infineon's Advanced Platform Baseband Products of Infineon Brief Introduction of BROADCOM's Acquisitions ADI's Mobile Phone Baseband Products Shipment of Spreadtrum's Mobile Phone Baseband Chips, 2005-2008 NXP's Baseband Products
---



→ 相关报告

- 2008-2009 年全球智能手机市场及产业链研究报告  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200902/24510929.html>
- 2008 年中国手机产业总结  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200812/24510914.html>
- 2008 年上半年中国手机出口市场研究报告  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200808/24510885.html>
- 2008 年上半年中国手机整机行业研究报告  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200809/24510893.html>
- 2007-2008 年全球手机内存行业研究报告  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200804/210.html>
- 2007-2008 年手机射频行业研究报告  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200804/221.html>
- 2007-2008 年手机应用处理器 IC（多媒体 IC）产业研究报告  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200806/24510839.html>
- 2007-2008 年手机显示屏行业研究报告  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200807/24510863.html>
- 2007-2008 年中国手机电池市场研究报告  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200809/24510895.html>
- 2007 年手机电视专题研究报告  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200803/53.html>
- 2007 年手机炒股专题研究报告  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200803/47.html>
- 2007 年手机电邮专题研究报告  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200803/43.html>
- 2007 年手机位置服务专题研究报告  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200803/50.html>
- 2007 年手机游戏专题研究报告  
<http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/200803/52.html>

## 关于我们

作为一家领先的产业研究和市场咨询机构，水清木华研究中心成立于 1999 年。

水清木华研究中心现有员工近百人，包含五个研究事业部：TMT 研究事业部，金融与服务业研究部，重工业研究部，能源与化工研究部，综合研究事业部。水清木华研究中心每年推出数百份产业研究报告，所有报告均提供中文和英文两种版本。

我们的研究内容包括竞争环境、市场现状和竞争格局、市场规模和未来预测、主要企业及战略规划、产品和技术趋势、投资机会和风险分析等。

研究中心广泛吸收各种先进的市场研究方法，利用强大的数据调查通路和合作伙伴资源，深入到市场的各个层面获取数据，全面真实地反映市场现状与趋势，为业界提供一流的市场趋势研究、产业和投资分析、上市企业研究、专项研究和市场监测服务。

水清木华研究中心拥有资深的行业分析师、经验丰富的市场调研人员、以及由业界权威专家组成的高级顾问团队。我们设立了专门的质量审核部门，建立了严谨的质量标准和完善的审核体系，多层次多方位把关，对咨询产品进行严格的校对和审查，以确保向客户提供高质量的产品和服务。

我们在国内外拥有上千家企业和机构客户，其中包括全球领先的制造商，商业和投资银行，保险公司，研究机构，金融服务公司，基金公司，政府公共机构，工业和技术客户等。

## About us

ResearchInChina was established in 1999, has become a leading independent provider of China business intelligence. Our research is designed to meet the diverse planning and information needs of businesses, institutions, and professional investors worldwide. Our services are used in a variety of ways, including strategic planning, product and sales forecasting, risk and sensitivity management, and as investment research.

We have over 500 clients worldwide, including the largest commercial and investment banks; insurance companies; research institutions; financial services firms; mutual funds; manufacturers; utilities; and industrial and technology clients.

## 联系方式

水清木华研究中心 中文: [www.pday.com.cn](http://www.pday.com.cn) 英文: [www.ResearchInChina.com](http://www.ResearchInChina.com)

### 北京总部:

电话: 86-10- 82601561、82601562、82601563 传真: 86-10- 82601570

地址: 北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 B 座 1105 邮编: 100083

### 上海办事处:

电话: 86-21-64873381 传真: 86-21-64872324

地址: 上海市徐家汇肇嘉浜路 825 号尚秀商务楼 2 号楼 6 楼 G2 室